

2005年12月26日

日立化成工業(蘇州)が半導体用封止材工場を竣工

日立化成工業株式会社(本社：東京、執行役社長：長瀬寧次、資本金：153億円)の子会社である日立化成工業(蘇州)有限公司(本社：江蘇省蘇州市、総経理：佐藤洋三、資本金：1,000万US\$)は、中国市場における半導体材料の事業基盤を強化するため、この度蘇州工業園區に約25億円を投じて、年間生産能力6,000トンの半導体用封止材工場を竣工いたしました。

中国における半導体産業は、日本、欧米を中心とした後工程の工場が多く進出していましたが、近年、日本、欧米、韓国などの有力半導体メーカーが前・後一貫工程の大規模工場を相次いで建設するとともに、中国国内においても各企業が半導体生産に乗りだしています。そのため、中国において半導体産業が急速に立ち上がりつつあり、今後更に、環境対応封止材の要求も高まってくることが見込まれております。当社は半導体材料メーカーとして、このような中国市場での需要拡大に対応するため、この度封止材工場を竣工し、ロジック向けを中心に環境対応封止材も含めたハイエンドの封止材生産を開始いたします。今後、お客様に材料を認定頂く作業を順次進めるとともに、早急に納期、技術サービス等の面でおお客様にご満足いただける体制を確立いたします。

日立化成グループは、現在日本及びマレーシアで半導体用封止材を生産しておりますが、今般中国で生産拠点を新設したことにより、年間約3万トンの供給体制が整いました。2010年には中国における市場占有率を現在の約20%(当社推定)から40%以上にまで高め、トップシェアを獲得する計画です。今後、本拠点を足掛かりに電子材料の中国事業の拡大を加速してまいります。

< 日立化成工業(蘇州)有限公司の概要 > (2005年11月末現在)

社名：日立化成工業(蘇州)有限公司
所在地：中国江蘇省蘇州市蘇州工業園區興浦路198号
資本金：1,000万US\$
株主：日立化成工業株式会社(100%)
代表者：総経理 佐藤洋三
従業員：30名(本格稼働時約100名)
事業内容：半導体用封止材の製造及び販売
総投資額：約25億円
土地面積：約66,000m²
生産能力：約6,000トン(年ベース)
本格稼働：2006年4月より

以上

(報道関係お問い合わせ)

日立化成工業株式会社 コーポレート戦略室 広報担当 野口 TEL 03-5381-2377